



반도체 (Positive)

테스트 장비사 발주 증가 및 CLT 장비 도입 근황

▶ Analyst 박준영 jyp94@hanwha.com 3772-7481 / RA 김나우 now.kim@hanwha.com 3772-7710

메모리 테스터 발주 큰 폭 증가

최근 들어 메모리 테스트 장비사향 대규모 발주가 늘고 있다. 번인 테스터를 주력으로 하는 다이아의 경우 6월~7월 2개월간 삼성전자로부터 총 5건의 수주, 1,423억원 규모의 검사장비 계약을 체결했으며 종속회사인 디지털 프론티어 또한 SK하이닉스로부터 금년 3건의 수주, 2321억원 규모의 HBM4 Wafer Tester 계약을 체결했다. 동일하게 번인 테스터를 주력으로 하는 와이씨의 경우 6월~8월 3개월간 삼성전자로부터 2건의 수주, 2,552억원 규모의 검사장비 계약을 체결했다. 이에 더해 메모리 패키지 테스터를 주력으로 하는 엑시콘 또한 2026년 5월~7월 3개월간 CLT 및 SSD 테스터 등 1,018억원의 검사장비 계약을 체결했다. 테스터 업체들향으로 대규모 발주가 이어지는 가운데 눈에 띄는 특징은 2개다. 삼성전자가 대량의 테스트 장비 발주를 시작했다는 점, 그리고 CLT라는 새로운 종류의 테스터 발주가 시작되었다는 점이다.

삼성전자 테스트 라인에 무슨 일이?

최근 삼성전자향 테스트 장비 발주가 크게 늘어나고 있는 현상은 삼성전자 HBM4의 약진에서부터 비롯되는 것으로 파악된다. 삼성전자는 HBM4의 본격적 발주와 함께 전 세대 대비 출하 물량이 빠르게 늘어나고 있으며, 이에 따라 HBM 후공정을 주력으로 하는 팹을 온양에 마련하려는 것으로 파악된다. 이에 따라 온양에서 기존에 진행되던 범용 DRAM, NAND용 테스트 장비들은 베트남에 신설되는 공장으로 이설 예정이며 베트남 팹에 추가로 설치할 테스터 발주도 늘리고 있는 모양새다. 이에 따라 삼성전자향으로 범용 메모리용 패키지 번인 테스터를 납품하는 다이아, 범용 메모리 및 HBM용 웨이퍼 번인 테스터를 납품하는 와이씨, 신규 테스터인 CLT 테스터를 납품하는 엑시콘이 대규모 수주의 수혜를 받고 있는 것으로 보인다. 삼성전자의 HBM4가 고속 특성(I/O Speed 11.7Gbps로 추정)을 바탕으로 점유율을 확대해 가는 과정에서 HBM 전용 테스터를 납품하는 업체들뿐만 아니라 범용 메모리용 테스터를 납품하는 업체들까지 수혜를 받는 모습이 확인되는 상황이다. 이는 삼성전자 HBM4 약진의 연쇄작용으로 해석되며 HBM이 DRAM 대비 2~3배가량 웨이퍼를 더 많이 사용한다는 점을 감안할 때 범용 메모리용 후공정 CAPA도 추가 증설이 필요한 상황인 것으로 보인다.

번인과 Low Frequency 검사를 통합한 CLT 도입 시작

최근 테스트 장비 발주에서 주목할 변화는 CLT(Chambered Low-Frequency Tester)의 도입이다. CLT는 패키징이 완료된 DRAM을 대상으로 번인과 Low Frequency 검사를 하나의 챔버 안에서 해결할 수 있는 장비다. 번인은 고온/고전압 환경을 조성해 DRAM에 스트레스를 주는 과정이고, Low Frequency는 낮은 속도로 데이터를 반복해서 쓰고 읽으며 정상 작동 여부를 확인하는 과정이다.

구체적으로는 다수의 DRAM이 장착된 인터페이스보드를 챔버 내부 슬롯에 넣은 뒤, 챔버의 온도를 높이고 각 DRAM에 전압을 인가한다. 이 상태에서 테스터가 DRAM에 데이터를 쓰고 다시 읽는 동작을 반복하며 응답값을 확인한다. 이를 통해 고온/고전압 스트레스에 취약한 제품과 기본적인 읽기/쓰기 기능에 문제가 있는 제품을 선별한다. 기존처럼 번인 이후 제품을 꺼내 별도의 Low Frequency 테스터로 이동, 재투입할 필요가 없어 검사시간과 장비 설치면적을 줄일 수 있다.

엑시콘의 CLT는 최대 200MHz의 시험속도와 -20~150℃의 온도 범위를 지원하며, 2개 챔버와 48개 슬롯을 통해 최대 11,520개의 DRAM을 동시에 검사하는 것으로 알려져 있다. 병렬검사(Para) 개수가 낮은 구형 테스터들 대비 높은 Throughput을 보인다고 할 수 있다. 최근 장비 중 비교 대상이 될 수 있는 장비는 변인과 Core Test를 통합한 어드반테스트의 H5620으로 추측된다. 동 장비는 16,896개의 병렬 검사를 지원하지만 장비 및 관련 부품 비용을 감안했을 때 국산 장비에 우위가 있을 것으로 추측된다. 향후 테스트 장비 산업에서 CLT 장비의 도입 속도와 테스터 업체들의 성장을 지켜볼만한 상황으로 보인다.

[표1] 2026년 주요 반도체 테스트 장비사의 삼성전자·SK하이닉스향 신규 수주 현황

(단위: 억 원)

공시일	기업명	공시명	계약내용	계약상대	계약금액
2026-06-10	디아이	단일판매 · 공급계약체결(자율공시)	반도체 검사장비 공급계약	Samsung Electronics(Suzhou) Semiconductor Co., Ltd.	210.4
2026-06-10	디아이	단일판매 · 공급계약체결	반도체 검사장비 공급계약	삼성전자(주) (Samsung Electronics Co., Ltd.)	724.9
2026-06-17	디아이	단일판매 · 공급계약체결	반도체 검사장비 공급계약	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd	223.4
2026-07-02	디아이	단일판매 · 공급계약체결(자율공시)	반도체 검사장비 공급계약	삼성전자(주) (Samsung Electronics Co., Ltd.)	169.2
2026-07-30	디아이	[기재정정]단일판매 · 공급계약체결(자율공시)	반도체 검사장비 공급계약 (DDR5용 차세대 BURN IN TESTER 및 NAND용 고속 BURN IN TESTER)	삼성전자(주) (Samsung Electronics Co., Ltd.)	95.6
2026-03-04	엑시콘	단일판매 · 공급계약체결	CLT 및 SSD Tester	주식회사 삼성전자	302.0
2026-06-04	엑시콘	단일판매 · 공급계약체결	반도체검사장비(CIB 등)	삼성전자	120.7
2026-07-10	엑시콘	단일판매 · 공급계약체결	CLT 및 SSD Tester	삼성전자	498.5
2026-07-27	엑시콘	[기재정정]단일판매 · 공급계약체결	CLT Interface Board	삼성전자	96.9
2026-04-13	와이씨	단일판매 · 공급계약체결	MT6133 LPE-B Upgrade	삼성전자(주)	421.6
2026-06-01	와이씨	단일판매 · 공급계약체결	반도체 검사장비	삼성전자(주)	930.0
2026-06-29	와이씨	[기재정정]단일판매 · 공급계약체결	반도체 검사장비	삼성전자(주)	387.5
2026-06-29	와이씨	[기재정정]단일판매 · 공급계약체결	반도체 검사장비	삼성전자(주)	403.0
2026-08-27	와이씨	단일판매 · 공급계약체결	반도체 검사장비(Memory Wafer Tester)	삼성전자(주)	1,621.5
2026-05-12	유니테스트	단일판매 · 공급계약체결	반도체 검사장비 (HBM4 WAFER TESTER)	SK하이닉스	291.6
2026-07-23	유니테스트	단일판매 · 공급계약체결	반도체 검사장비 (HBM4 WAFER TESTER)	SK하이닉스	226.8

자료: Dart, 한화투자증권 리서치센터

[그림1] 엑시콘의 CLT



자료: 엑시콘, 한화투자증권 리서치센터

[그림2] 디아이의 BURN-IN TESTER



자료: 디아이, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice]

(공표일: 2026년 9월 2일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 본인은 이 자료에서 다른 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 본인은 이 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박준영, 김나우)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다른 종목을 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

[종목 투자등급]

당사는 개별 종목에 대해 향후 1년간 +15% 이상의 절대수익률이 기대되는 종목에 대해 Buy(매수) 의견을 제시합니다. 또한 절대수익률 -15~+15%가 예상되는 종목에 대해 Hold(보유) 의견을, -15% 이하가 예상되는 종목에 대해 Sell(매도) 의견을 제시합니다. 밸류에이션 방법 등 절대수익률 산정은 개별 종목을 커버하는 애널리스트의 추정에 따르며, 목표주가 산정이나 투자의견 변경 주기는 종목별로 다릅니다.

[산업 투자의견]

당사는 산업에 대해 향후 1년간 해당 업종의 수익률이 과거 수익률에 비해 양호한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Positive(긍정적) 의견을 제시하고 있습니다. 또한 향후 1년간 수익률이 과거 수익률과 유사한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Neutral(중립적) 의견을, 과거 수익률보다 부진한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Negative(부정적) 의견을 제시하고 있습니다. 산업별 수익률 전망은 해당 산업 내 분석대상 종목들에 대한 담당 애널리스트의 분석과 판단에 따릅니다.

[당사 조사분석자료의 투자등급 부여 비중]

(기준일: 2026년 6월 30일)

투자등급	매수	중립	매도	합계
금융투자상품의 비중	96.3%	3.7%	0.0%	100.0%